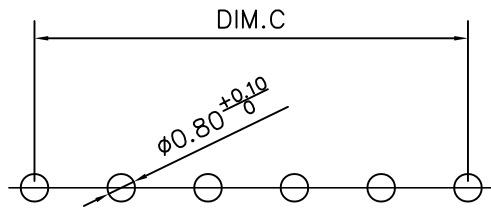
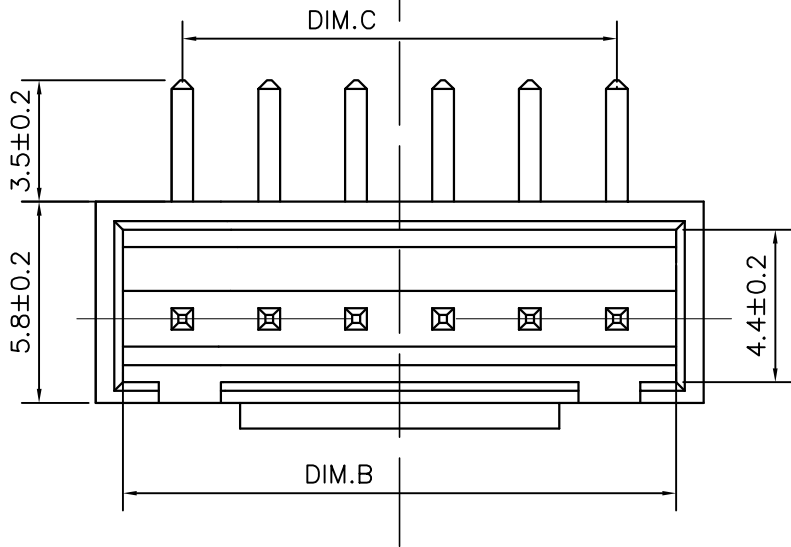
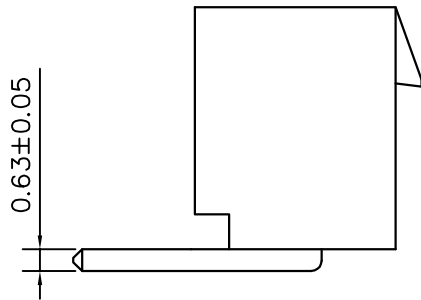
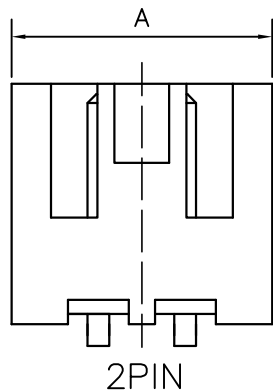
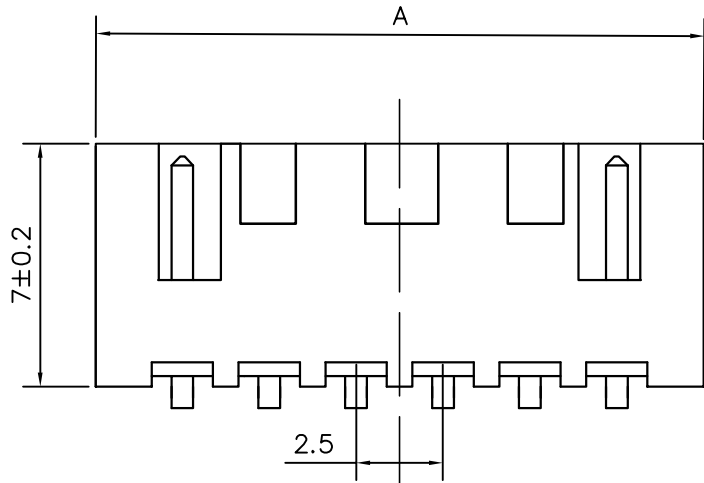


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Pin	DIM A	DIM B	DIM C
2	7.50	6.10	2.50
3	10.00	8.60	5.00
4	12.50	11.10	7.50
5	15.00	13.60	10.00
6	17.50	16.10	12.50
7	20.00	18.60	15.00
8	22.50	21.10	17.50
9	25.00	23.60	20.00
10	27.50	26.10	22.50
11	30.00	28.60	25.00
12	32.50	31.10	27.50
13	35.00	33.60	30.00
14	37.50	36.10	32.50
15	40.00	38.60	35.00



PCB LAYOUT

技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm

温度范围: -25℃~85℃

额定电压: 250V AC/DC


额定电流: 3A

接触电阻: ≤0.01Ω

绝缘电阻: ≥1000MΩ

耐 压: 1000V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

料 号
PART NO

针座
HC-XHB-8AW-M

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

